

## Перечень технологических направлений

1. Оборудование.
  - 1.1. Оборудование для выращивания эпитаксиальных структур.
  - 1.2. Оборудование для формирования топологического рисунка.
  - 1.3. Оборудование для ионной имплантации.
  - 1.4. Физико-термическое оборудование.
  - 1.5. Оборудование для плазмохимического осаждения, травления и очистки.
  - 1.6. Оборудование для физического осаждения.
  - 1.7. Оборудование для химической и гальванической обработки.
  - 1.8. Лазерное оборудование.
  - 1.9. Оборудование для химико-механической планаризации, шлифовки, полировки и утонения.
  - 1.10. Метрологическое оборудование (межоперационный контроль, в том числе характеристик тестовых структур, разбраковки кристаллов).
  - 1.11. Оборудование для контроля электрофизических параметров и аналитики.
  - 1.12. Оборудование и оснастка для сборки и контроля качества (испытания) опытных образцов электронной компонентной базы.
2. Специальные материалы.
  - 2.1. Высокочистые химические вещества и реагенты, специальные газы и смеси газов, металлоорганические соединения.
  - 2.2. Комплекс материалов для литографии.
  - 2.3. Полупроводниковые материалы.
  - 2.4. Эпитаксиальные структуры кремния.
  - 2.5. Высокочистые металлы и сплавы, мишени, композиционные металлические материалы.
  - 2.6. Технологические материалы.
  - 2.7. Композиционные материалы, керамические материалы, диэлектрики и другие.
3. Системы автоматизированного проектирования.